

## DDR4 DIMM

TE 内部编号 9-2199155-4

DIMM Sockets, Double Data Rate (DDR) 4, Board-to-Bus Bar, 288 Position, Surface Mount, Vertical Module Orientation, DDR4 DIMM

[在 TE 官网查看>](#)[连接器](#) > [接口插槽](#) > [内存插槽](#) > [DIMM 插槽](#) > [DDR4 DIMM 插槽](#)DRAM 类型: **双倍数据速率 (DDR) 4**连接器系统: **板对母排**位数: **288**PCB 端接方法: **表面贴装**模块方向: **垂直**[所有 DDR4 DIMM 插槽 \(69\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 4
连接器系统	板对母排

### 结构特性

位数	288
模块方向	垂直

### 主体特性

弹射器类型	标准
-------	----

### 接触件特性

端子额定电流 (最大值)	.75 A
--------------	-------

### 端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

中心线 (间距)	.85 mm [.033 in]
----------	------------------



## 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

## 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

## 包装特性

封装方法	硬托盘
------	-----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | DDR4 DIMM



## 客户还购买了



## 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2199155-4\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2199155-4\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_9-2199155-4\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

[产品规格](#)

英文版本